

Title (en)
DEVICE FOR CUTTING MATERIAL.

Title (de)
VORRICHTUNG ZUM SCHNEIDEN VON MATERIAL.

Title (fr)
DISPOSITIF SERVANT A COUPER UNE MATIERE.

Publication
EP 0548161 A1 19930630 (EN)

Application
EP 91916182 A 19910910

Priority
• SE 9100597 W 19910910
• SE 9002870 A 19900910

Abstract (en)
[origin: WO9204164A1] Device for cutting of materials by means of at least one cutting means, which partly is provided to be controlled by preferably a plotter or the like, partly to be heated to a temperature, which is higher than the melting temperature of the material by electric induction and/or resistance heating, and partly comprises a cutting part (30) and a holder part (31) connected thereto. The cutting part (30) is constituted by a cutting electrode formed as a substantially cylindrical pin with considerably smaller cross sectional area than the holder part (31), so that the cutting part emits substantially the whole amount of heat generated by current supplied, and that the electrode (30) is connected into a control circuit for controlling the temperature of the electrode in dependence on its cutting speed.

Abstract (fr)
Dispositif servant à couper des matières à l'aide d'au moins un mécanisme tranchant, conçu en partie pour être commandé de préférence par un traceur ou similaire, en partie pour être porté à une température supérieure à la température de fusion de la matière à trancher par induction électrique et/ou par chauffage ohmique; lledit mécanisme comporte en outre une partie tranchante (30) et une partie porte-outil (31). La partie tranchante (30) est constituée par une électrode tranchante ayant la configuration d'une aiguille pratiquement cylindrique qui possède une superficie de section sensiblement plus petite que la partie porte-outil (31) de sorte que la partie tranchante émet virtuellement toute la chaleur générée par le courant d'alimentation; l'électrode (30) est connectée au circuit de commande pour réguler la température de l'électrode en fonction de sa vitesse de coupe.

IPC 1-7
B26F 3/08

IPC 8 full level
B26F 1/38 (2006.01); **B26F 3/08** (2006.01)

CPC (source: EP)
B26F 1/3806 (2013.01); **B26F 3/08** (2013.01); **B26D 2007/2678** (2013.01)

Citation (search report)
See references of WO 9204164A1

Designated contracting state (EPC)
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

DOCDB simple family (publication)
WO 9204164 A1 19920319; AT E131101 T1 19951215; DE 69115281 D1 19960118; EP 0548161 A1 19930630; EP 0548161 B1 19951206; JP H06505923 A 19940707; SE 9002870 D0 19900910

DOCDB simple family (application)
SE 9100597 W 19910910; AT 91916182 T 19910910; DE 69115281 T 19910910; EP 91916182 A 19910910; JP 51504191 A 19910910; SE 9002870 A 19900910